

2027年3月期 第1四半期 決算説明会

2026年7月30日

代表取締役社長 兼 執行役員社長
最高経営責任者
作島 史朗

2027.3期 第1四半期 実績

(単位：百万円 / () 内の数字は売上高比率)

	2027.3期 第1四半期	前年同期比	
		増減金額	増減率
売上高	525,383	47,345	9.9%
税引前利益	74,891 (14.3%)	30,328	68.1%
親会社の所有者に 帰属する四半期利益	60,576 (11.5%)	23,433	63.1%

- ✓ 前年同期と比較して大幅な増益
- ✓ 第1四半期として売上高・利益とも過去最高

コアコンポーネント

- 半導体製造装置向けファインセラミック部品、及びAIデータセンター向け半導体パッケージの販売増を主因に大幅な増収増益

電子部品

- AIデータセンター向けの小型大容量MLCCやタンタルコンデンサ等の販売増を主因に増収増益

ソリューション

- 主要既存事業において需要が増加した一方、前4Qにおける米国機械工具子会社の譲渡完了に伴う売上減の影響により減収
- 主要既存事業の増収効果及び収益性改善により増益

2027.3期 通期業績予想

(単位：百万円 / () 内の数字は売上高比率)

	2027.3期 今回予想(7月公表)	2026.3期比	前回予想比
		増減金額	増減金額
売上高	2,080,000	9,797	140,000
税引前利益	200,000 (9.6%)	31,006	30,000
親会社の所有者に 帰属する当期利益	160,000 (7.7%)	19,031	19,000

- ✓ 本年4月公表予想を上方修正
- ✓ 過去最高売上高の更新と大幅な増益の達成を図る

コアコンポーネント

- 主にAIデータセンター向け製品の市場拡大の影響及び為替変動の影響により上方修正

電子部品

- AIデータセンター向けのコンデンサ等の販売増の影響及び為替変動を主因に上方修正

ソリューション

- 各事業の収益性向上に加え、為替変動の影響により上方修正

1. 2027.3期 第1四半期 決算概要
2. 2027.3期 業績予想
3. 【ご参考】 補足資料

1. 2027.3期 第1四半期 決算概要

2027.3期 第1四半期 実績(1)



(単位：百万円 / () 内の数字は売上高比率)

		2026.3期 第1四半期	2027.3期 第1四半期	増減	
				金額	率
売上高		478,038	525,383	47,345	9.9%
営業利益		18,550 (3.9%)	49,101 (9.3%)	30,551	164.7%
税引前利益		44,563 (9.3%)	74,891 (14.3%)	30,328	68.1%
親会社の所有者に帰属する四半期利益		37,143 (7.8%)	60,576 (11.5%)	23,433	63.1%
平均為替 レート	米ドル	145円	159円		
	ユーロ	164円	185円		

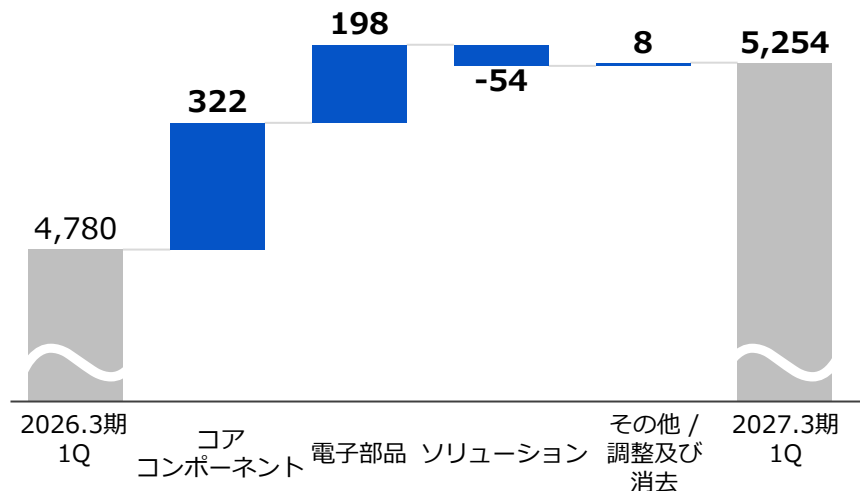
付記事項

- 為替レート変動（円安）の影響額：売上高 約+350億円 / 税引前利益 約+70億円

売上高

- コアコンポーネント及び電子部品は、主にAIデータセンター向けの半導体パッケージやコンデンサ等の旺盛な需要に伴い増収
- ソリューションは、主要既存事業において需要が増加した一方、前4Qにおける米国機械工具子会社の譲渡完了に伴う売上減の影響により減収

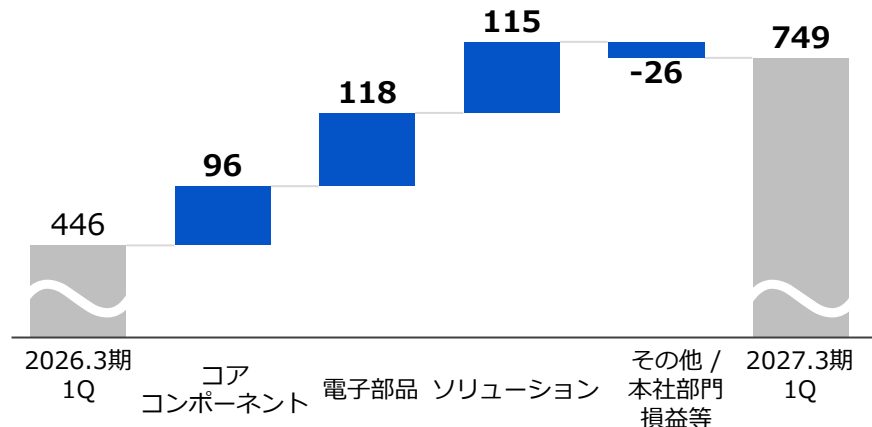
(単位：億円)



税引前利益

- AIデータセンター向けの高付加価値製品の増収により、コアコンポーネント及び電子部品の収益が拡大
- ソリューションは主要既存事業の増収効果及び収益性改善により増益

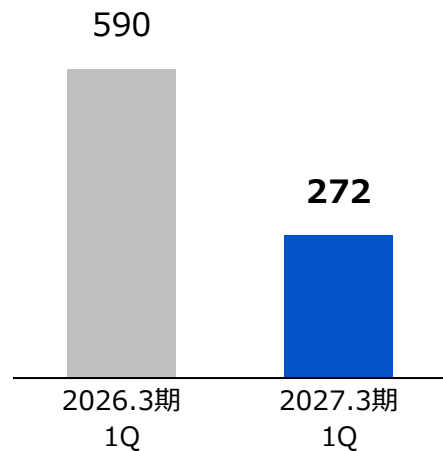
(単位：億円)



設備投資額

過年度より着手していた国内工場の新棟建設が前期に完工したことを主因として減少

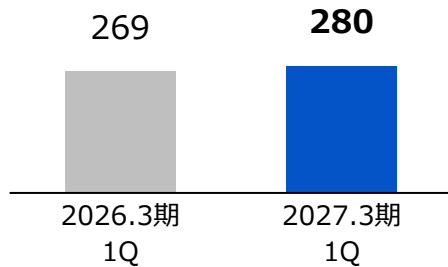
(単位：億円)



有形固定資産 減価償却費

主に為替の影響により微増

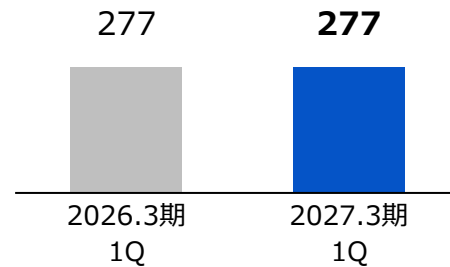
(単位：億円)



研究開発費

注力領域における新製品及び新事業の展開に向けた研究開発を継続

(単位：億円)



2027.3期 第1四半期 セグメント別売上高



(単位：百万円)

	2026.3期 第1四半期		2027.3期 第1四半期		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
コアコンポーネント	145,856	30.5%	178,081	33.9%	32,225	22.1%
産業・車載用部品	58,523	12.2%	65,446	12.5%	6,923	11.8%
半導体関連部品	81,561	17.1%	106,106	20.2%	24,545	30.1%
その他	5,772	1.2%	6,529	1.2%	757	13.1%
電子部品	83,864	17.6%	103,645	19.7%	19,781	23.6%
ソリューション	253,007	52.9%	247,627	47.1%	-5,380	-2.1%
機械工具	80,038	16.7%	56,842	10.8%	-23,196	-29.0%
ドキュメントソリューション	107,415	22.5%	122,092	23.2%	14,677	13.7%
コミュニケーション	45,586	9.5%	47,977	9.1%	2,391	5.2%
その他	19,968	4.2%	20,716	4.0%	748	3.7%
その他の事業	3,430	0.7%	3,878	0.8%	448	13.1%
調整及び消去	-8,119	-1.7%	-7,848	-1.5%	271	—
売上高	478,038	100.0%	525,383	100.0%	47,345	9.9%

2027.3期 第1四半期 セグメント別利益



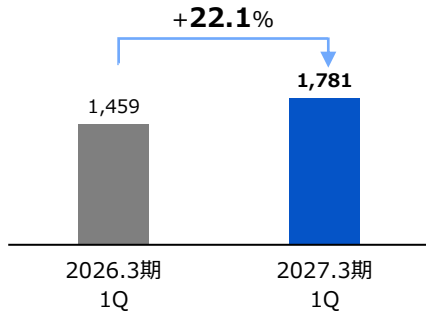
(単位：百万円)

	2026.3期 第1四半期		2027.3期 第1四半期		増減	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
コアコンポーネント	14,188	9.7%	23,826	13.4%	9,638	67.9%
産業・車載用部品	6,992	11.9%	9,984	15.3%	2,992	42.8%
半導体関連部品	7,021	8.6%	13,919	13.1%	6,898	98.2%
その他	175	3.0%	-77	—	-252	—
電子部品	-3,008	—	8,782	8.5%	11,790	—
ソリューション	18,879	7.5%	30,333	12.2%	11,454	60.7%
機械工具	6,551	8.2%	11,723	20.6%	5,172	78.9%
ドキュメントソリューション	9,753	9.1%	11,383	9.3%	1,630	16.7%
コミュニケーション	206	0.5%	3,307	6.9%	3,101	—
その他	2,369	11.9%	3,920	18.9%	1,551	65.5%
その他の事業	-5,406	—	-6,323	—	-917	—
事業利益 計	24,653	5.2%	56,618	10.8%	31,965	129.7%
本社部門損益等	19,910	—	18,273	—	-1,637	-8.2%
税引前利益	44,563	9.3%	74,891	14.3%	30,328	68.1%

売上高

前年同期比較

(単位：億円)

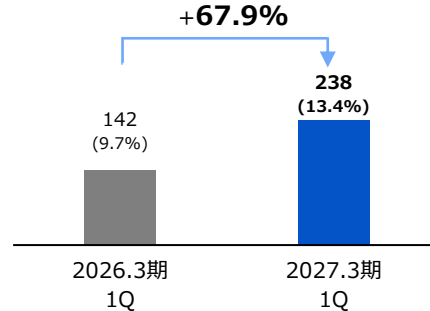


半導体製造装置向けファインセラミック部品、及びAIデータセンター向け半導体パッケージの販売増を主因に増加

事業利益（利益率）

前年同期比較

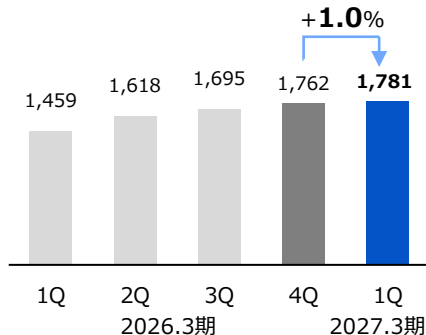
(単位：億円)



主にAIデータセンター向け半導体パッケージの増収効果により収益性が大幅に向上

直前四半期比較

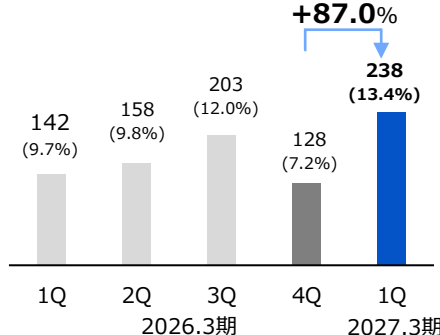
(単位：億円)



AIデータセンター向けセラミックパッケージや半導体製造装置向けファインセラミック部品の需要が堅調に推移

直前四半期比較

(単位：億円)

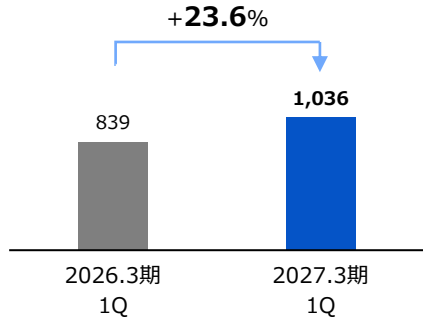


半導体製造装置向けファインセラミック部品を中心とした高付加価値製品の増収効果に加え、前4Qは旧ディスプレイ事業の減損損失(約50億円)を計上したこともあり大幅に増加

売上高

前年同期比較

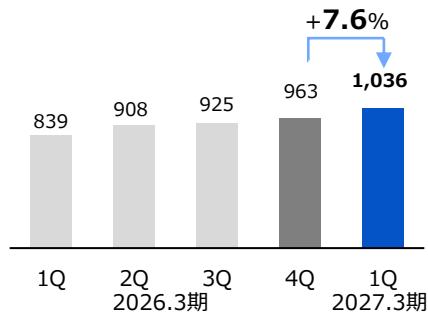
(単位：億円)



AIデータセンター向けの小型高容量MLCCやタンタルコンデンサ等の販売増を主因に増加

直前四半期比較

(単位：億円)

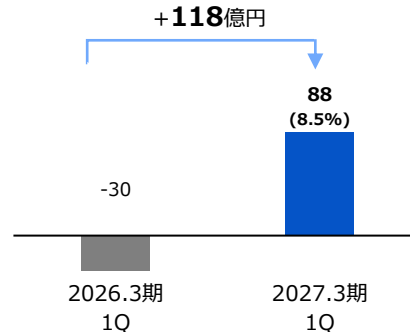


同上

事業利益（利益率）

前年同期比較

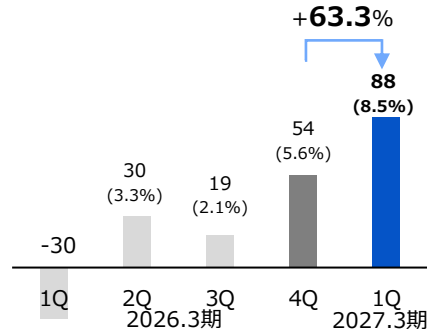
(単位：億円)



AIデータセンター向けの高付加価値製品の増収効果及び不動産売却益等(約30億円)を計上したことに加え、前1Qは事業譲渡に伴う一時損失(約21億円)を計上したこともあり、大幅に増加

直前四半期比較

(単位：億円)

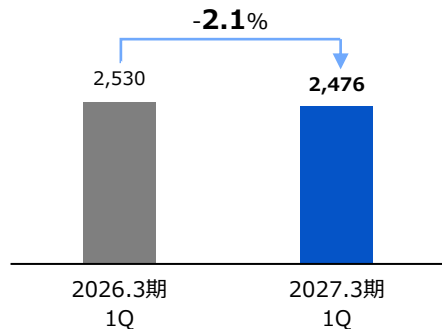


AIデータセンター向けの高付加価値製品の増収効果及び不動産売却益等(約30億円)の計上により増加

売上高

前年同期比較

(単位：億円)

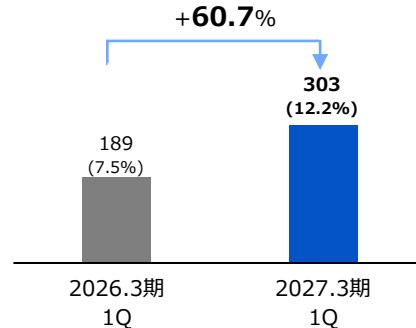


情報機器事業、機械工具事業等の主要既存事業において需要が増加した一方、前4Qにおける米国機械工具子会社の譲渡完了に伴う売上減(約360億円)の影響により減収

事業利益 (利益率)

前年同期比較

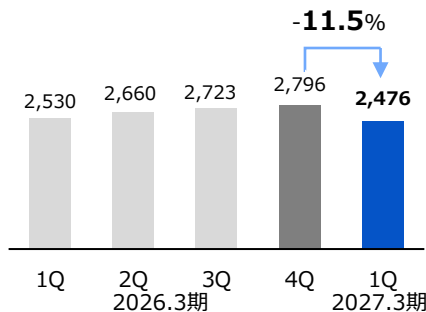
(単位：億円)



情報機器事業、機械工具事業等の主要既存事業の増収効果及び収益性改善に伴い増益

直前四半期比較

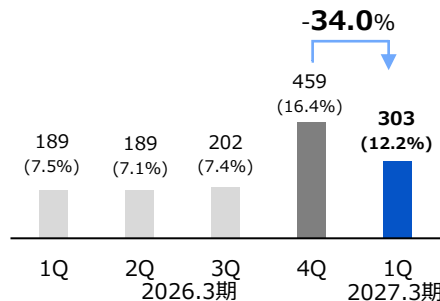
(単位：億円)



情報機器事業、コミュニケーション事業の季節要因により減収

直前四半期比較

(単位：億円)



前4Qに米国機械工具子会社譲渡における一時利益(約170億円)を計上したことにより減益

2. 2027.3期 業績予想

2027.3期 業績予想



(単位：百万円)

		2026.3期	2027.3期		増減金額	
			前回予想(4月公表)	今回予想(7月公表)	前期比	前回予想比
売上高		2,070,203	1,940,000	2,080,000	9,797	140,000
営業利益		118,138 (5.7%)	130,000 (6.7%)	160,000 (7.7%)	41,862	30,000
税引前利益		168,994 (8.2%)	170,000 (8.8%)	200,000 (9.6%)	31,006	30,000
親会社の所有者に 帰属する当期利益		140,969 (6.8%)	141,000 (7.3%)	160,000 (7.7%)	19,031	19,000
EPS(円)		102.70	102.73	122.04		
平均為替 レート	米ドル	151円	150円	155円		
	ユーロ	175円	175円	180円		
設備投資額		149,099 (7.2%)	225,000 (11.6%)	225,000 (10.8%)	75,901	—
有形固定資産 減価償却費		110,924 (5.4%)	120,000 (6.2%)	120,000 (5.8%)	9,076	—
研究開発費		115,701 (5.6%)	120,000 (6.2%)	120,000 (5.8%)	4,299	—

* 2027.3期予想のEPSは、4月公表予想は2026年3月期、7月公表予想は2027年3月期 第1四半期の期中平均株式数を用いて算出。

() 内の数字は売上高比率

2027.3期 セグメント別売上高予想



(単位：百万円)

	2026.3期		2027.3期				増減金額	
	金額	構成比	前回予想(4月公表)		今回予想(7月公表)		前期比	前回予想比
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		
コアコンポーネント	653,429	31.6%	654,000	33.7%	716,000	34.4%	62,571	62,000
産業・車載用部品	250,069	12.1%	246,000	12.7%	273,000	13.1%	22,931	27,000
半導体関連部品	379,432	18.3%	380,000	19.6%	415,000	20.0%	35,568	35,000
その他	23,928	1.2%	28,000	1.4%	28,000	1.3%	4,072	—
電子部品	363,486	17.5%	364,000	18.7%	415,000	20.0%	51,514	51,000
ソリューション	1,070,919	51.7%	932,800	48.1%	964,800	46.4%	-106,119	32,000
機械工具	285,936	13.8%	170,000	8.8%	180,000	8.6%	-105,936	10,000
ドキュメントソリューション	478,479	23.1%	480,000	24.7%	490,000	23.6%	11,521	10,000
コミュニケーション	219,158	10.6%	188,000	9.7%	200,000	9.6%	-19,158	12,000
その他	87,346	4.2%	94,800	4.9%	94,800	4.6%	7,454	—
その他の事業	14,196	0.7%	15,000	0.8%	15,000	0.7%	804	—
調整及び消去	-31,827	-1.5%	-25,800	-1.3%	-30,800	-1.5%	1,027	-5,000
売上高	2,070,203	100.0%	1,940,000	100.0%	2,080,000	100.0%	9,797	140,000

2027.3期 セグメント別利益予想



(単位：百万円)

	2026.3期		2027.3期				増減金額	
	金額	売上高比	前回予想(4月公表)		今回予想(7月公表)		前期比	前回予想比
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	売上高比		
コアコンポーネント	63,082	9.7%	80,500	12.3%	99,000	13.8%	35,918	18,500
産業・車載用部品	18,730	7.5%	28,000	11.4%	36,000	13.2%	17,270	8,000
半導体関連部品	46,933	12.4%	53,000	13.9%	63,500	15.3%	16,567	10,500
その他	-2,581	—	-500	—	-500	—	2,081	—
電子部品	7,316	2.0%	21,000	5.8%	26,000	6.3%	18,684	5,000
ソリューション	103,943	9.7%	87,600	9.4%	94,000	9.7%	-9,943	6,400
機械工具	35,196	12.3%	16,000	9.4%	18,000	10.0%	-17,196	2,000
ドキュメントソリューション	45,115	9.4%	45,000	9.4%	47,000	9.6%	1,885	2,000
コミュニケーション	12,116	5.5%	13,200	7.0%	15,000	7.5%	2,884	1,800
その他	11,516	13.2%	13,400	14.1%	14,000	14.8%	2,484	600
その他の事業	-21,742	—	-26,000	—	-26,000	—	-4,258	—
事業利益 計	152,599	7.4%	163,100	8.4%	193,000	9.3%	40,401	29,900
本社部門損益等	16,395	—	6,900	—	7,000	—	-9,395	100
税引前利益	168,994	8.2%	170,000	8.8%	200,000	9.6%	31,006	30,000

	本年4月公表予想（前回予想）	本年7月公表予想（今回予想）
事業環境	• 原材料価格の高騰や地政学リスク等不透明な状況の継続を懸念 • AI関連投資の加速が見込まれる一方、自動車関連市場は減速の見通し • 為替相場については緩やかな円高を想定	• 不透明な事業環境は継続 • AI及び半導体関連市場をはじめとする広範な分野において需要拡大が先行 • 為替相場については円安が進行

1Qに需要拡大が先行した影響及び円安の影響を考慮し上方修正

ただし、原材料価格の高騰や地政学リスク等の影響が2Q以降に顕在化する想定は継続

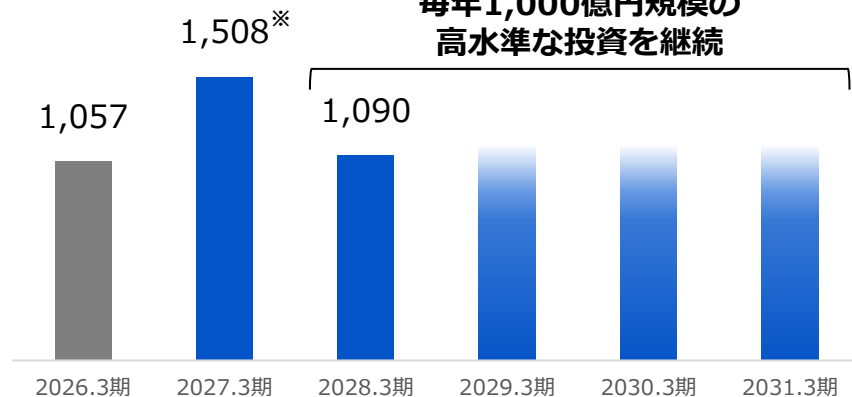
部品事業の投資計画の概要

2026.3期～2031.3期（6年間）の計画

先端半導体・AI周辺領域を中心とした部品事業に

約**6,500**億円を投じる計画を立案

毎年1,000億円規模の
高水準な投資を継続



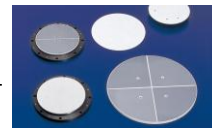
先端半導体・AI周辺領域ビジネス
売上高 **2.8**倍を目指す (2026.3期比)

※長崎諫早工場の完工を予定していることから大幅に増加

注力領域の見通し

半導体 製造装置向け ファイン セラミック 部品

- ✓ 主要顧客からの堅調な年間需要見通しの提示
- ✓ 需要増加の見通しに基づく
中期的な生産人員の増強や
生産容量拡大投資の前倒し検討



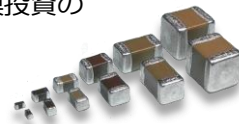
AI周辺 ネットワーク用 パッケージ

- ✓ 光通信用セラミックパッケージの大幅な出荷
増加及び増産投資進捗中
- ✓ ネットワーク用有機パッケージの
需要拡大及びガラス材の確保対応



AIサーバー・ 半導体向け 小型大容量 MLCC

- ✓ データセンター/半導体市場向けの需要急増、
長期供給契約の締結
- ✓ 生産容量拡大に向けた大規模投資の
手配開始
- ✓ 新製品の歩留り改善による
品質向上と生産容量拡大



利益成長に伴いROE予想を4.9%に引き上げ / ROE 5%以上達成の1年早期化を目指す

- 当期利益(分子): 業績予想の上方修正を反映
- 株主資本(分母): 株主還元は計画通りに実施中

【今回予想】
2027.3期
ROE 4.9%

2028.3期
目標
ROE 5.0%
以上

2026.3期
実績
ROE 4.3%

【前回予想】
2027.3期
ROE 4.3%

インオーガニック成長

オーガニック成長（AI関連製品、ソリューション事業の着実な拡大）

継続的な資本構成の最適化（政策保有株式の縮減・株主還元の強化）

3. 【ご参考】 補足資料

注：2027.3期より、「その他の事業」に含めていた要素技術研究等を「本社部門損益等」に含めて業績管理することとしました。これに伴い、同条件での比較を行うため、P.22に記載の2026年3月期の業績についても、同様の管理区分にて表示しています。

事業セグメント別 売上高



百万円 / Yen in millions

	2026年3月期 / Fiscal 2026					2027年3月期 / Fiscal 2027				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	145,856	161,802	169,512	176,259	653,429	178,081				
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	58,523	60,372	63,245	67,929	250,069	65,446				
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	81,561	95,748	100,123	102,000	379,432	106,106				
その他 Others	5,772	5,682	6,144	6,330	23,928	6,529				
電子部品 Electronic Components Business	83,864	90,845	92,487	96,290	363,486	103,645				
ソリューション Solutions Business	253,007	266,014	272,245	279,653	1,070,919	247,627				
機械工具 Industrial Tools Unit	80,038	76,945	74,304	54,649	285,936	56,842				
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	107,415	113,505	121,735	135,824	478,479	122,092				
コミュニケーション Communications Unit	45,586	53,229	54,149	66,194	219,158	47,977				
その他 Others	19,968	22,335	22,057	22,986	87,346	20,716				
その他の事業 Others	3,430	3,193	3,947	3,626	14,196	3,878				
調整及び消去 Adjustments and Eliminations	-8,119	-8,507	-7,580	-7,621	-31,827	-7,848				
売上高 Sales Revenue	478,038	513,347	530,611	548,207	2,070,203	525,383				

事業セグメント別 利益



百万円 / Yen in millions

	2026年3月期 / Fiscal 2026					2027年3月期 / Fiscal 2027				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント	14,188	15,832	20,324	12,738	63,082	23,826				
Core Components Business										
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	6,992	4,968	7,512	-742	18,730	9,984				
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	7,021	12,094	12,533	15,285	46,933	13,919				
その他 Others	175	-1,230	279	-1,805	-2,581	-77				
電子部品	-3,008	3,025	1,920	5,379	7,316	8,782				
Electronic Components Business										
ソリューション	18,879	18,883	20,235	45,946	103,943	30,333				
Solutions Business										
機械工具 Industrial Tools Unit	6,551	3,733	2,538	22,374	35,196	11,723				
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	9,753	8,371	11,020	15,971	45,115	11,383				
コミュニケーション Communications Unit	206	3,994	3,459	4,457	12,116	3,307				
その他 Others	2,369	2,785	3,218	3,144	11,516	3,920				
その他の事業 Others	-5,406	-6,655	-4,821	-4,860	-21,742	-6,323				
事業利益 計 Total Business Profit	24,653	31,085	37,658	59,203	152,599	56,618				
本社部門損益等 Corporate Gains and Others	19,910	-7,698	16,422	-12,239	16,395	18,273				
税引前利益	44,563	23,387	54,080	46,964	168,994	74,891				
Profit Before Income Taxes										

事業セグメント別 受注高



百万円 / Yen in millions

	2026年3月期 / Fiscal 2026					2027年3月期 / Fiscal 2027				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	149,408	158,161	164,251	169,103	640,923	194,342				
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	59,516	60,777	64,381	70,435	255,109	75,602				
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	84,112	91,632	93,742	91,949	361,435	112,268				
その他 Others	5,780	5,752	6,128	6,719	24,379	6,472				
電子部品 Electronic Components Business	89,273	91,501	91,963	100,442	373,179	124,191				
ソリューション Solutions Business	268,411	270,096	267,088	295,195	1,100,790	254,507				
機械工具 Industrial Tools Unit	80,602	77,461	76,170	56,900	291,133	58,925				
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	107,807	113,431	121,647	135,741	478,626	121,973				
コミュニケーション Communications Unit	60,357	57,278	47,914	79,102	244,651	54,117				
その他 Others	19,645	21,926	21,357	23,452	86,380	19,492				
その他の事業 Others	2,758	2,570	3,180	3,070	11,578	3,105				
調整及び消去 Adjustments and Eliminations	-6,684	-6,430	-5,197	-9,894	-28,205	-7,631				
受注高 Orders	503,166	515,898	521,285	557,916	2,098,265	568,514				

事業セグメント別 設備投資額



百万円 / Yen in millions

	2026年3月期 / Fiscal 2026					2027年3月期 / Fiscal 2027				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	40,566	12,241	16,494	9,458	78,759	6,374				
電子部品 Electronic Components Business	7,240	7,733	5,269	6,689	26,931	12,659				
ソリューション Solutions Business	4,188	6,571	7,289	5,932	23,980	4,457				
その他の事業 Others	1,670	1,262	672	428	4,032	1,464				
本社部門 Corporate	5,351	1,918	4,189	3,939	15,397	2,219				
合計 Total	59,015	29,725	33,913	26,446	149,099	27,173				

事業セグメント別 有形固定資産減価償却費



百万円 / Yen in millions

	2026年3月期 / Fiscal 2026					2027年3月期 / Fiscal 2027				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	10,186	10,699	10,781	10,838	42,504	10,335				
電子部品 Electronic Components Business	7,568	7,619	7,783	7,711	30,681	8,030				
ソリューション Solutions Business	6,121	6,303	6,548	6,285	25,257	6,354				
その他の事業 Others	588	651	720	735	2,694	811				
本社部門 Corporate	2,408	2,447	2,445	2,488	9,788	2,489				
合計 Total	26,871	27,719	28,277	28,057	110,924	28,019				

百万円 / Yen in millions

	2026年3月期 / Fiscal 2026					2027年3月期 / Fiscal 2027				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント Core Components Business	6,470	6,597	6,383	6,670	26,120	5,774				
電子部品 Electronic Components Business	3,097	4,423	4,116	4,252	15,888	3,931				
ソリューション Solutions Business	9,212	9,100	9,383	9,804	37,499	8,697				
その他の事業 Others	4,867	4,753	4,689	3,989	18,298	5,230				
本社部門 Corporate	4,059	4,600	4,622	4,615	17,896	4,069				
合計 Total	27,705	29,473	29,193	29,330	115,701	27,701				

将来の見通しに関する記述等について

この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 日本及び世界経済の一般的な状況
- (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化
- (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響
- (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力
- (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプライヤーの供給能力及びその価格の変動
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 今後の取り組み又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生まない事態
- (8) 買収した会社又は取得した資産から成果や事業機会が得られない事態
- (9) 優れた人材の確保が困難となる事態
- (10) サイバー攻撃等により当社の情報セキュリティが被害を受ける事態及びその復旧や維持に多額の費用が必要となるリスク
- (11) 当社の企業秘密及び特許を含む知的財産権の保護が不十分である事態
- (12) 当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用
- (13) 既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触
- (14) 環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担
- (15) 世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態
- (16) 疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響
- (17) 地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
- (18) 売掛債権の信用リスク
- (19) 当社が保有する金融商品の価値の変動
- (20) 当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
- (21) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (22) 会計基準の変更

上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は黙示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を負いません。



京セラ株式会社